

新產品:AgCoat Prime 完美的性價比

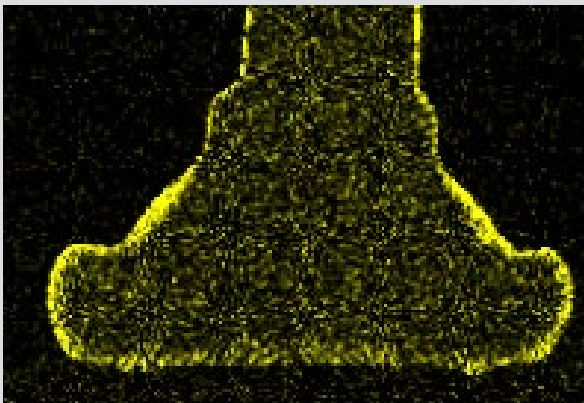
AgCoat Prime是全球首款可真正替代金線的鍵合線,是記憶體領域的理想選擇。AgCoat Prime是一款表面鍍金的銀線。憑藉獨特的結構設計,該產品有助於客戶降低成本、減少人力,並且更好地控制生產時間。

AgCoat Prime的主要優勢

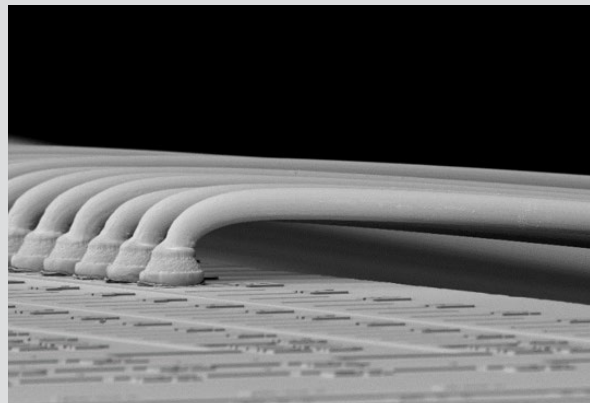
- 鍵合過程中實現無惰性氣體保護下燒球(FAB)
- 與銀合金線相比,使用壽命更長(60天)
- 提高第二焊點的作業性
- 與金線相比,提高了高溫存儲(HTS)和溫度循環(TC)的能力
- 利用客戶現有生產設施,無需任何額外的固定資產投資
- 可以使用現有的鍵合機
- 金屬間化合物(IMC)的生長比金線緩慢
- 可與金線的MTBA相似(大於4小時)



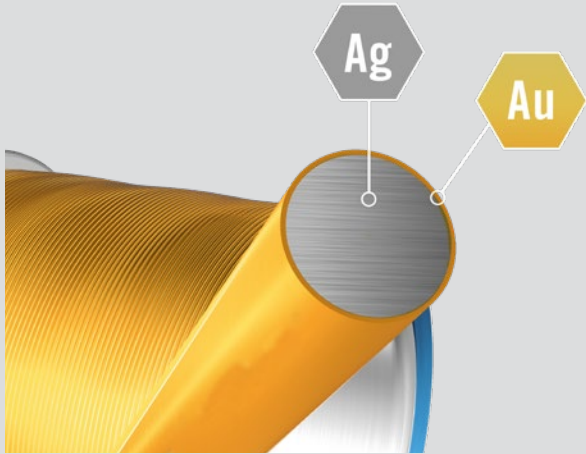
金覆蓋和低線弧鍵合引線



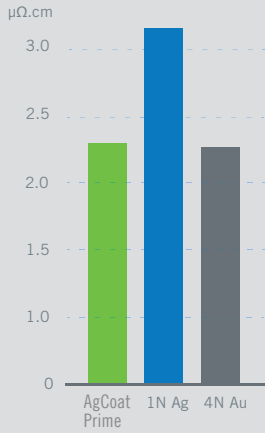
金覆蓋鍵合後的球



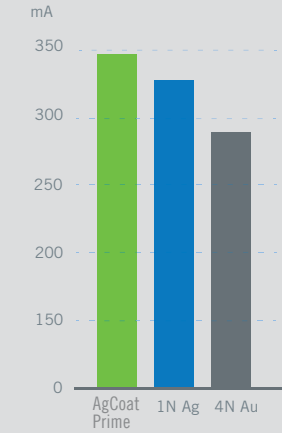
超低線弧高度不超過2.4mil,不會出現頸部裂紋



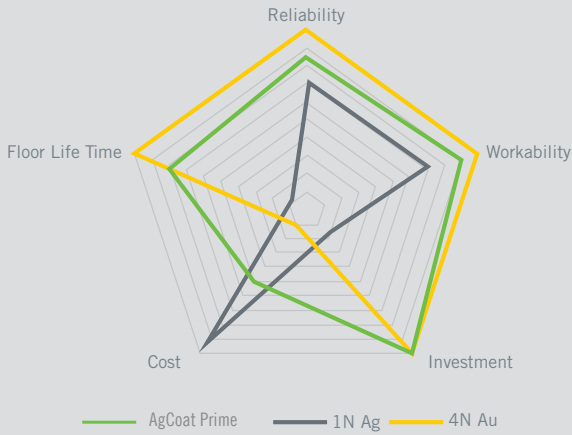
電阻率



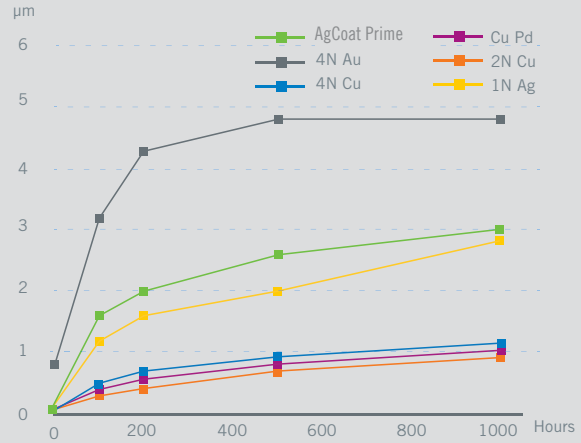
熔斷電流



優勢/性能比較



金屬間化合物生產



賀利氏電子
 Heraeus Deutschland GmbH & Co. KG
 Heraeusstraße 12-14
 63450 Hanau, Germany
 www.heraeus-electronics.com

美洲地區
 電話 +1 610 825 6050
 electronics.americas@heraeus.com

中國
 電話 +86 21 3357 5457
 electronics.china@heraeus.com

韓國
 電話 +82 31 270 9400
 electronics.korea@heraeus.com

亞太
 電話 +65 6571 7677
 electronics.apac@heraeus.com

歐洲、中東和非洲
 電話 +49 6181 35 3627
 electronics.emea@heraeus.com

本文所述事實與技術數據均由賀利氏利用最新知識和現代實驗設備根據通用實驗流程測定得出。文中資訊均為出版前最新版本(可索要最新版本權)。儘管數據均準確無誤,但賀利氏對上述數據是否得到合理引用或因引用上述數據導致的任何侵權後果均不承擔任何責任(除非事先以協定的形式獲得明確的書面同意)。消費者應根據本文所提供的數據針對特定應用對材料適用性進行測試。賀利氏標識、Heraeus、賀利氏和AgCoat為賀利氏集團或其附屬公司的商標或註冊商標。保留所有權利。